

2021-2026年中国半导体封装设备市场调查研究及 行业投资潜力预测报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2021-2026年中国半导体封装设备市场调查研究及行业投资潜力预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/channel/semicon/694081.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

半导体封装是指将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程。封装过程为：来自晶圆前道工艺的晶圆通过划片工艺后被切割为小的晶片（Die），然后将切割好的晶片用胶水贴装到相应的基板（引线框架）架的小岛上，再利用超细的金属（金锡铜铝）导线或者导电性树脂将晶片的接合焊盘（BondPad）连接到基板的相应引脚（Lead），并构成所要求的电路；然后再对独立的晶片用塑料外壳加以封装保护，塑封之后还要进行一系列操作，封装完成后进行成品测试，通常经过入检Incoming、测试Test和包装Packing等工序，最后入库出货。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第1章：半导体封装设备行业界定及发展环境剖析

1.1 半导体封装设备行业界定及统计说明

1.1.1 半导体封装设备在半导体产业链中的地位

1.1.2 半导体封装设备的界定与工作原理

（1）半导体封装的界定

（2）半导体封装设备工作原理

（3）半导体封装设备的分类

1.1.3 本行业关联国民经济行业分类

1.1.4 本报告行业研究范围的界定说明

1.1.5 本报告的数据来源及统计标准说明

1.2 中国半导体封装设备行业技术环境

1.2.1 半导体封装技术分析

1.2.2 半导体封装设备技术创新动态

1.2.3 半导体封装设备相关专利申请及公开情况

1.2.4 半导体封装设备技术创新趋势

1.2.5 技术环境对行业发展的影响分析

1.3 中国半导体封装设备行业政策环境

1.3.1 行业监管体系及机构介绍

1.3.2 行业标准体系建设现状

（1）标准体系建设

（2）现行标准汇总

(3) 即将实施标准

(4) 重点标准解读

1.3.3 行业发展相关政策规划汇总及解读

(1) 行业发展相关政策汇总

(2) 行业发展相关规划汇总

1.3.4 行业重点政策规划解读

1.3.5 政策环境对行业发展的影响分析

1.4 中国半导体封装设备行业经济环境

1.4.1 宏观经济发展现状

1.4.2 宏观经济发展展望

1.4.3 行业发展与宏观经济相关性分析

1.5 中国半导体封装设备行业社会环境

1.5.1 中国人口规模及结构

1.5.2 中国城镇化水平变化

1.5.3 中国居民收入水平及结构

1.5.4 中国居民消费支出水平及结构演变

1.5.5 中国消费新趋势

1.5.6 社会环境变化对行业发展的影响分析

第2章：全球半导体封装设备行业发展趋势及预测

2.1 全球半导体封装设备行业发展历程及发展环境分析

2.1.1 全球半导体封装设备行业发展历程

2.1.2 全球半导体封装设备行业发展环境

2.2 全球半导体封装设备行业供需状况及市场规模测算

2.2.1 全球半导体封装设备行业供需状况

2.2.2 全球半导体封装设备行业市场规模测算

2.3 全球半导体封装设备行业区域发展格局及重点区域市场研究

2.3.1 全球半导体封装设备行业区域发展格局

2.3.2 重点区域半导体封装设备行业发展分析

(1) 韩国

(2) 美国

(3) 日本

2.4 全球半导体封装设备行业市场竞争状况分析

2.4.1 全球半导体封装设备行业市场竞争状况

2.4.2 全球半导体封装设备企业兼并重组状况

2.5 全球半导体封装设备行业发展趋势及市场前景预测

2.5.1全球半导体封装设备行业发展趋势预判

2.5.2全球半导体封装设备行业市场前景预测

第3章：中国半导体封装设备行业发展现状与市场痛点分析

3.1中国半导体封装设备行业发展历程及市场特征

3.1.1中国半导体封装设备行业发展历程

3.1.2中国半导体封装设备市场发展特征

3.2中国半导体封装设备所属行业进出口状况分析

3.2.1中国半导体封装设备所属行业进出口概况

3.2.2中国半导体封装设备所属行业进口状况

(1) 行业进口规模

(2) 行业进口价格水平

(3) 行业进口产品结构

(4) 行业主要进口来源地

(5) 行业进口趋势及前景

3.2.3中国半导体封装设备所属行业出口状况

(1) 行业出口规模

(2) 行业出口价格水平

(3) 行业出口产品结构

(4) 行业主要出口来源地

(5) 行业出口趋势及前景

3.3中国半导体封装设备所属行业市场供需状况

3.3.1中国半导体封装设备行业参与者类型及规模

3.3.2中国半导体封装设备行业参与者进场方式

3.3.3中国半导体封装设备行业市场供给分析

3.3.4中国半导体封装设备行业市场分析

3.3.5中国半导体封装设备行业价格水平及走势

3.4中国半导体封装设备行业市场规模测算

3.5中国半导体封装设备行业市场痛点分析

第4章：中国半导体封装设备行业竞争状态及市场格局分析

4.1中国半导体封装设备行业市场进入与退出壁垒

4.2中国半导体封装设备行业投融资、兼并与重组状况

4.2.1中国半导体封装设备行业投融资发展状况

(1) 行业资金来源

(2) 投融资主体

(3) 投融资方式

- (4) 投融资事件汇总
- (5) 投融资信息汇总
- (6) 投融资趋势预测
- 4.2.2 中国半导体封装设备行业兼并与重组状况
 - (1) 兼并与重组事件汇总
 - (2) 兼并与重组动因分析
 - (3) 兼并与重组案例分析
 - (4) 兼并与重组趋势预判
- 4.3 中国半导体封装设备行业市场格局及集中度分析
 - 4.3.1 中国半导体封装设备行业市场竞争格局
 - 4.3.2 中国半导体封装设备行业国际竞争力分析
 - 4.3.3 中国半导体封装设备行业国产化发展现状
 - 4.3.4 中国半导体封装设备行业市场集中度分析
- 4.4 中国半导体封装设备行业波特五力模型分析
 - 4.4.1 上游议价能力分析
 - 4.4.2 下游议价能力分析
 - 4.4.3 行业内企业竞争分析
 - 4.4.4 替代品威胁分析
 - 4.4.5 潜在进入者分析
 - 4.4.6 行业市场竞争总结
- 第5章：中国半导体封装设备产业链梳理及全景深度解析
 - 5.1 半导体封装设备产业链梳理及成本结构分析
 - 5.1.1 半导体封装设备产业链结构及生态体系
 - 5.1.2 半导体封装设备的组成结构
 - 5.1.3 半导体封装设备成本结构
 - 5.2 中国半导体封装设备行业上游供应市场解析
 - 5.2.1 半导体封装设备行业上游原材料类型
 - 5.2.2 半导体封装设备上游核心组件类型
 - 5.2.3 半导体封装设备上游供应状况分析
 - 5.2.4 上游供应对半导体封装设备行业发展的影响分析
 - 5.3 半导体封装设备行业设计市场
 - 5.4 半导体封装设备行业中游细分产品市场分析
 - 5.4.1 贴片机
 - 5.4.2 划片机
 - 5.4.3 引线焊接设备

5.4.4 电镀设备

5.4.5 塑封/切筋成型设备

5.5 半导体制造领域对半导体封装设备的需求分析

第6章：全球及中国半导体封装设备代表性企业发展布局案例研究

6.1 中国半导体封装设备代表性企业发展布局对比

6.2 全球半导体封装设备行业代表性企业布局案例

6.2.1 日本Hitachi High-Technologies（日立高新）

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业半导体封装设备业务布局现状
- (4) 企业半导体封装设备业务投融资状况

6.2.2 荷兰ASM International（先域）

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业半导体封装设备业务布局现状
- (4) 企业半导体封装设备业务投融资状况

6.2.3 库力索法半导体Kulicke & Soffa(“K&S”)

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业半导体封装设备业务布局现状
- (4) 企业半导体封装设备业务投融资状况

6.2.4 日本新川shinkawa

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业半导体封装设备业务布局现状
- (4) 企业半导体封装设备业务投融资状况

6.2.5 荷兰BE Semiconductor Industries N.V.(Besi)

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业半导体封装设备业务布局现状
- (4) 企业半导体封装设备业务投融资状况

6.3 中国半导体封装设备代表性企业发展布局案例

6.3.1 北京艾科瑞斯科技有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况

(3) 企业半导体封装设备布局状况

(4) 企业半导体封装设备布局的优劣势分析

6.3.2 大连佳峰自动化股份有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

(3) 企业半导体封装设备布局状况

(4) 企业半导体封装设备布局的优劣势分析

6.3.3 深圳市易天自动化设备股份有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

(3) 企业半导体封装设备布局状况

(4) 企业半导体封装设备布局的优劣势分析

6.3.4 深圳市溢旭电子有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

(3) 企业半导体封装设备布局状况

(4) 企业半导体封装设备布局的优劣势分析

6.3.5 广东木几智能装备有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

(3) 企业半导体封装设备布局状况

(4) 企业半导体封装设备布局的优劣势分析

6.3.6 北京中科同志科技股份有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

(3) 企业半导体封装设备布局状况

(4) 企业半导体封装设备布局的优劣势分析

6.3.7 巨力精密设备制造(东莞)有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

(3) 企业半导体封装设备布局状况

(4) 企业半导体封装设备布局的优劣势分析

第7章：中国半导体封装设备行业市场分析及投资策略

7.1 中国半导体封装设备行业发展潜力评估(AK HT)

7.1.1 行业发展现状总结

7.1.2行业影响因素总结

7.1.3行业发展潜力评估

(1) 行业生命发展周期

(2) 行业发展潜力评估

7.2中国半导体封装设备行业发展前景预测

7.3中国半导体封装设备行业发展趋势预判

7.4中国半导体封装设备行业投资风险预警与防范策略

7.4.1中国半导体封装设备行业投资风险预警

7.4.2中国半导体封装设备投资风险防范策略

7.5中国半导体封装设备行业投资价值评估

7.6中国半导体封装设备行业投资机会分析

7.7中国半导体封装设备行业投资策略与建议

7.8中国半导体封装设备行业可持续发展建议

图表目录:

图表1：半导体封装设备在半导体工艺流程中的位置

图表2：半导体封装设备工作原理

图表3：半导体封装设备分类及说明

图表4：《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》中半导体封装设备行业所归属类别

图表5：本报告半导体封装设备行业研究范围界定

图表6：本报告的主要数据来源及统计标准说明

图表7：2020年半导体封装设备行业标准汇总

图表8：2020年半导体封装设备行业发展政策汇总

图表9：2020年半导体封装设备行业发展规划汇总

图表10：2016-2020年中国大陆人口数量情况（单位：亿人）

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.huaon.com/channel/semicon/694081.html>